

航天时代电子技术股份有限公司关于公司全资子公司 北京时代民芯科技有限公司洁净间建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司北京时代民芯科技有限公司（下称“时代民芯公司”）为提升芯片封装能力，拟对其租用的科研生产场所进行改造，投资建造洁净间及配套设施；

● 项目估算总投资 2,900 万元；

一、本次投资概述

时代民芯公司成立于 2005 年，为公司全资子公司，主营业务包括半导体集成电路设计、封装及测试和可靠性考核等服务，为确保封装关键技术及产品质量深度自主可控，推动形成多芯粒集成产品先进封装能力，时代民芯公司需要建造 RDL/UBM(晶圆焊盘下金属化层和布线层制备)封装生产线。

时代民芯公司目前在北京的生产经营场地均为租用的北京微电子技术研究所的场所，为构建 RDL/UBM 先进封装工艺能力，2024 年 4 月，时代民芯公司与北京微电子技术研究所签订了《二号科研楼租赁合同》，租用北京微电子技术研究所二号科研楼 1900 平方米作为科研生产场所用于相关设备安置以及配套设施建设，租期至 2032 年 12 月 31 日，年租金 78.4 万元。该经营场地的关联租赁包含在公司 2024 年度日常经营性关联交易事项中，公司 2024 年日常经营性关联交易已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年 7 月 17 日，公司董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于北京时代民芯科技有限公司洁净间建设的议案》，议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次投资的主要内容

（一）建设目标

时代民芯公司拟对租用的科研生产场所适应性改造，建设成为满足先进封装工艺设备安置及环境要求的百/千级洁净间，为时代民芯公司封装能力的提升提供支撑。

（二）建设内容

1、改造满足光刻和物理气相沉积等先进封装工艺设备安置要求的百/千级洁净间共计 1105 平方米；

2、改造满足洁净间空调和工艺设备等运行所需动力设施安置要求的辅助用房共计 645 平方米；

3、新建满足工艺设备日常运行所需的工艺循环冷却水系统、废气收集及处理系统、废水收集设备等配套设施。

（三）投资估算及资金来源

项目估算总投资 2,900 万元，其中工程费用 2,378 万元，工程建设其他费 368.12 万元，基本预备费 153.88 万元，资金来源为时代民芯公司自筹。

（四）建设周期

建设周期 8 个月。

三、本次投资对公司的影响

时代民芯公司通过本次洁净间及配套设施建设，有利于提升其先进封装工艺能力，满足其封装产业化发展需要，为承担更多型号任务提供了基础保障条件，有利于公司和股东利益最大化。

四、本次投资的风险分析

根据租赁合同约定：1、租赁期满，时代民芯公司具有优先继续承租资格；如北京微电子技术研究所不再续租，将对时代民芯公司出资建造的洁净间予以评估，按照评估残值及其他可利用价值对时代民芯公司予以经济补偿。2、在租赁期内，若北京微电子技术研究所因无法继续出租该房屋而导致时代民芯公司或公司遭受任何损失（包括但不限于因第三人主张权力或有权政府部门行使职权导致

民芯公司或公司无法正常使用该房屋，由此产生搬迁、停产等经济损失的；或者因该房屋被有权政府部门处以罚款、被有关当事人追索等而产生额外费用或支出），北京微电子技术研究所将予以全额现金补偿。综上，时代民芯公司在租赁场地上出资建造洁净间不存在较大风险。

根据与地方行政主管部门的提前沟通情况，时代民芯公司本次洁净间及配套设施建设工程可办理施工许可证等许可事项，不存在行政审批风险。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年7月24日

● 备查文件：

1. 公司董事会 2024 年第八次会议决议；
2. 二号科研楼租赁合同。